



2026年10月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号:6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

中際旭創股份有限公司（InnoLight社）との戦略的協業契約締結に関するお知らせ

—AI及びデータセンター向け高速光通信を支えるTEC、ヒートシンク基板などの分野での協業—

株式会社フェローテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：賀 賢漢、以下「当社」）の連結子会社である杭州大和熱磁電子有限公司は、AIDC（AIデータセンター）向け光インターコネクト・ソリューションを提供する中際旭創股份有限公司（以下、「InnoLight社」）との間で、TEC（半導体熱電冷却素子）(*1)、サブマウント（Submount）(*2)等の製品供給および共同開発、ならびにその他のAIDC向け光インターコネクト製品に必要な技術・材料分野における協業を目的とする戦略的協業契約（以下「本協業」）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 協業の目的および背景

- ・生成AIやクラウドサービスの普及に伴い、大量の情報を高速かつ効率的に伝送する光通信の重要性が、データセンターにおいて一層高まっています。光モジュールの大容量化・高密度化が進む中、通信性能に加え、温度制御、放熱、パッケージの信頼性および安定供給への対応が求められています。
- ・InnoLight社は、AIインフラおよびクラウドコンピューティング用途向けの高速光インターコネクト製品を提供する大手企業です。400G、800Gおよび1.6T等の高速光モジュールを展開するとともに、シリコンフォトニクス技術(*3)に基づく次世代光インターコネクト製品の研究開発および量産を推進しています。
- ・当社グループは、熱電半導体技術および精密材料技術を基盤として、光デバイスの温度制御に用いられるTECおよび温度センサー（サーミスタ）、ならびに放熱機能を担うサブマウント向け絶縁放熱基板等の製品・技術を提供しています。
- ・本協業では、InnoLight社の高速光通信分野における技術力・市場での影響力と、当社グループの製品開発・製造技術を組み合わせ、製品供給、共同開発、品質向上およびサプライチェーンの連携を推進します。
- ・当社は、本協業をTEC事業の成長機会の拡大と、AIDC向け光インターコネクト関連デバイス・材料分野における事業基盤の強化に向けた重要な取り組みと位置付けています。次世代光通信のニーズに応える製品・技術の高度化を継続し、中長期的な競争力の強化と企業価値の向上を目指してまいります。

(ご参考) 主な技術・製品

- (*1)TEC：Thermo-Electric Coolerの略。電流によって吸熱・発熱作用を生じる熱電素子であり、光通信分野ではレーザー等の温度制御に用いられている。
- (*2)サブマウント（Submount）：半導体チップ等を搭載し、パッケージングおよび放熱を支える部材。
- (*3)シリコンフォトニクス技術：シリコンチップを基盤とし、光通信経路及び光学機能を集積する技術。本資料では、協業先の技術発展動向を説明するためにこの用語を使用している。

2. 本協業の内容と目指す方向性

(1) 本協業の内容

- ・ AI 向け新インターコネクト分野、新デバイス分野、新材料分野における製品協力・共同研究開発・サプライチェーン連携、事業化協力等を行うこと。

(2) 目指す方向性

- ・ TEC、サブマウント等の製品を通じ、AIDC向け光インターコネクト製品の用途に関連する事業機会の拡大。
- ・ 共同開発を通じた製品の性能・品質を向上と次世代光通信技術のニーズへの対応力の向上。
- ・ 生産・納入面での連携を通じた供給体制の強化およびコスト最適化の推進。

3. 協業先の概要

(1) 事業内容

InnoLight社は、高速光トランシーバーの研究開発、設計、製造および販売を行う有力企業であり、世界の大手中クラウドサービス事業者およびAIコンピューティング・ソリューション提供企業に向けた光インターコネクト製品・ソリューションの提供に注力しています。100Gから1.6Tまでの製品ラインアップを展開しています。

(2) 会社概要

(1)	名称	中際旭創股份有限公司（英文名：ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.）		
(2)	所在地	中国山東省龍口市諸由觀鎮駐地		
(3)	代表者	董事長兼總裁 劉聖（Liu Sheng）		
(4)	設立年月日	2005年6月27日		
(5)	資本金	11.78億中国元（約278億円） ※ 1 中国元＝23.66円		
(6)	大株主及び持ち分比率	株主名	持ち分比率	
		山东中际投资控股有限公司	10.31%	
		王伟修	5.92%	
		香港中央结算有限公司	5.36%	
		HKSCC Nominees Limited	5.32%	
		苏州益兴福企业管理中心	3.96%	
		苏州云昌锦企业管理中心	2.03%	
		Lumiza Limited	1.31%	
		易方达創業板ETF〔工商銀行名義〕	0.80%	
		苏州福睿晖企业管理中心	0.69%	
	中国人寿保險・伝統型普通保險商品	0.64%		
(7)	上場市場 (参考) 時価総額・株価	・A株上場：深圳証券取引所・創業板（ChiNext）証券コード：300308.SZ		
		・H株上場：香港証券取引所・メインボード 証券コード：03308.HK		
		参考時価総額：約9,267億中国元（約22兆円）※中国元＝23.66円		
		参照株価時点：2026年10月9日15時（中国時間）		
		参考株価（A株）：775.29中国元（同時点）		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません	
		人的関係	該当事項はありません	
		取引関係	当社のTEC製品の主要取引先の1社です。	
(9)	最近3年間の財政状態及び経営成績 ※ 1 中国元＝23.66円			
決算期	2023年12月期	2024年12月期	2025年12月期	
総資産	20,006,75百万元 (4,734億円)	28,866,28百万元 (6,830億円)	45,288.97百万元 (10,715億円)	

親会社株主に帰属する純資産	14,261.02 百万元 (3,374 億円)	19,133.89 百万元 (4,527 億円)	29,765.16 百万元 (7,042 億円)
1 株当たり純資産	18.14 円 (429 円)	17.32 円 (410 円)	26.79 円 (634 円)
売上高	10,717.98 百万元 (2,536 億円)	23,862.16 百万元 (5,646 億円)	38,239.94 百万元 (9,048 億円)
営業利益	2,173.53 百万元 (514 億円)	5,171.49 百万元 (1,224 億円)	13,596.92 百万元 (3,217 億円)
親会社株主に帰属する当期純利益	2,173.53 百万元 (514 億円)	5,171.49 百万元 (1,224 億円)	10,797.25 百万元 (2,555 億円)
1 株当たり当期純利益	2.00 円 (47 円)	4.72 円 (112 円)	9.80 円 (232 円)
1 株当たり配当金	0.45 円 (11 円)	0.50 円 (12 円)	1.40 円 (33 円)

4. 日程

契 約 締 結 日	2026年10月中（予定）
取 締 役 会 決 議 日	2026年10月20日
提 携 開 始 日	2026年10月中（予定）

5. 今後の見通し

当社は、InnoLight社との協力を通じて、AI・データセンター向け高速光通信分野におけるTEC・サブマウント等の事業機会の拡大を図るとともに、次世代デバイス・材料の開発に取り組んでまいります。本協業を中長期的な成長基盤の強化につなげ、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

本件が2026年12月期以降の当社連結業績に与える影響については、今後の具体的な取引および共同開発の進捗等を踏まえて精査してまいります。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上